

上海市科学技术委员会

江苏省科学技术厅

浙江省科学技术厅

安徽省科学技术厅

沪科合〔2024〕18号

关于开展 2024 年度长三角科技创新共同体
联合攻关重点揭榜任务工作的通知

各有关单位：

为贯彻落实《长三角科技创新共同体建设发展规划》《长三角科技创新共同体联合攻关合作机制》等文件精神，根据《长三

角科技创新共同体联合攻关计划实施办法(试行)》，在长三角科技创新共同体建设工作专班指导下，上海市科学技术委员会、江苏省科学技术厅、浙江省科学技术厅、安徽省科学技术厅(以下简称“一市三省科技主管部门”)联合开展 2024 年度长三角科技创新共同体联合攻关重点揭榜任务工作，现将有关事宜通知如下。

一、工作目标

以“科创+产业”为引领，立足国家战略，聚焦长三角重点产业领域创新需求，推动企业成为技术创新决策、科研投入、组织科研和成果转化的主体，进行有组织科研攻关，共同服务国家战略使命和区域发展需要，协同突破一批关键核心技术，争取在 3 年内取得一批标志性成果，合力推动重点产业链关键核心技术实现自主可控，提升产业链供应链安全性和竞争力，培育和发展新质生产力。

二、有关要求

(一) 揭榜任务

本通知发布的重点任务来自《关于开展 2024 年度长三角科技创新共同体联合攻关需求征集工作的通知》征集的需求。经专家需求评估后，形成 41 项需求任务清单(详见附件),需求详细信息登录平台注册后可见。

(二) 揭榜对象

本揭榜任务面向国际国内有条件、有能力解决榜单需求的科研机构、企业和创新团队。揭榜方应遵守科研诚信管理要求，

应承诺所提交材料真实性，不得提交有涉密内容的项目申请。

（三）揭榜流程

1. 揭榜方登录“长三角一体化科创云平台”（<http://www.csj-stcloud.com>）--联合攻关--点击“方案提交”，按系统提示提交解决方案。揭榜方可选择揭榜任务中一项或多项提出解决方案。

2. 平台管理方自需求发布起，在入库截止时间之前，实时将收到的解决方案推送至需求方。

3. 需求方对解决方案的技术可行性、与需求的匹配性等方面进行综合研判，必要时可与揭榜方进行充分沟通，有多个解决方案可供选择时，可通过项目路演，加速精准匹配。

平台管理方将配合需求方做好沟通衔接、专家推荐、路演组织等服务保障工作。鼓励长三角区域国家综合性科技创新中心、长三角创新联合体等战略科技力量积极响应企业需求，动态组织、集结科研优势力量，提出解决方案。

（四）储备入库

需求方找到合适的解决方案时，可登录云平台，提出“入库申请”，提交解决方基本信息，经管理平台确认后纳入长三角科技创新共同体联合攻关项目储备库。储备入库包括但不限于以下情形：

1. 对外揭榜需求全部找到意向解决方案的，可入库，显示“揭榜成功”状态；

2. 对外揭榜需求部分找到意向解决方案的，可入库，显示

“部分揭榜成功”状态，需求方继续寻找合适的解决方案；

3. 对外揭榜需求全部未解决，暂不入库，需求持续有效。

在攻关名称和任务不变的情况下，需求方可结合研发实际，调整其中部分对外揭榜需求，但不影响其他揭榜任务按程序执行。

一市三省科技主管部门根据《长三角科技创新共同体联合攻关合作机制》及配套实施办法的相关要求，组织后续项目申报。

（五）揭榜任务要求

1. 需求方应立足国家战略，发挥创新引领示范带动作用，组织长三角区域高校、科研院所及企业优势科研力量，组建跨学科、跨领域、跨区域创新联合体，推动项目、人才、平台、资金一体化配置，联合攻关以解决难题。

2. 联合攻关应突出以解决关键技术、重大工程或重点企业应用等为目标成果转化和产业化合作。

3. 需求方的合作单位中，应包括需求方所在省（市）以外的至少一家长三角区域单位参与。

（六）时间节点

项目储备入库截止时间为2024年10月18日16:30。

三、咨询方式

电话：021-24197781、24197753、24197793、24197749

邮箱：lhgg@sstec.org.cn

附件：2024年长三角科技创新共同体联合攻关重点揭榜任务清单

上海市科学技术委员会

江苏省科学技术厅

浙江省科学技术厅

安徽省科学技术厅

2024年9月27日

（此件主动公开）

附件

2024 年长三角科技创新共同体联合攻关 重点揭榜任务清单

一、集成电路领域

(一) 面向低轨卫通的低成本高可靠多通道全链路核心芯片研发

(二) 车规级智能栅极驱动芯片研发

(三) 8 英寸固态装配型压电 MEMS 器件工艺平台及其产业化应用

(四) 半导体晶圆隐形切割空间光调制关键技术及光路系统设计

(五) 车规级 FC-BGA SiP 封装技术研发及产业化

(六) 面向激光雷达芯片的 TSV 垂直通孔封装工艺开发

(七) 多层超薄芯片堆叠、高精度贴装技术研究

(八) Chiplet 先进封装应用之硅桥嵌埋 FC-BGA 封装载板开发

二、人工智能领域

(一) 基于多模态大模型的车载电子部件咨询诊断智能系统

(二) 语音对话大模型关键技术研究及多行业场景应用

(三) 智能线控转向系统关键技术与产业化

(四) 基于深度学习与大数据的智能医疗助行车关键技术

研究

(五) 基于多模态数据的心血管疾病智能诊断与风险防控关键技术研究及应用

(六) 基于多模态和车联网的安全驾驶辅助系统

(七) 基于国产芯片和区块链智能合约的视频压缩存算硬件系统关键技术与应用示范

(八) 面向智能白色家电电子部件缺陷的多模态智能检测技术及应用示范

(九) 基于数字孪生的机场跑道健康监测与智能运维系统及应用

(十) 面向智能机器人高精度操作的位姿感知芯片及微执行器

(十一) 核电深水冷却管道泥沙沉积探测机器人系统研发

(十二) 关于人工智能与融合通信技术在城市运行“一网统管”领域的深化研究

(十三) 基于数字孪生的洗/干衣机智能制造关键技术研究

(十四) 新能源汽车自主工业软件开发

(十五) 智能仓储关键技术研究及应用

三、生物医药领域

(一) 面向重大疾病治疗的核酸药物递送关键技术攻关及产业化

(二) 治疗性干细胞生产应用中的核心技术攻关

(三) 长三角抗体药物产业关键技术攻关

(四) 高效、高选择性酶催化不对称氧化反应关键技术研究及产业化应用

(五) 酶催化定点偶联 ADC (抗体偶联药物) 的关键技术

(六) 基于生物展示技术的肽类药物发现技术研发

(七) 基于 NGS 液体活检技术的恶性肿瘤诊断产品研发

(八) 基于运动意图感知的肢体运动功能康复机器人系统关键技术研究

(九) 心脑血管及代谢性疾病临床质谱检验项目的标准化研究

(十) 用于阿尔兹海默早期诊断和分期的多靶标超灵敏血浆蛋白标志物联合检测关键技术研究

(十一) 合成生物智能高通量培养基和细胞株筛选装备开发

(十二) 无线微创手术系统的创新与应用

四、未来产业领域

(一) 宽温域宽频率工况的国产航空交流电动泵设计研究

(二) 面向海底应用的大容量光通信与海洋信息感知一体化融合系统

(三) 面向先进微纳制造的大幅面高精度运动平台及控制系统开发

(四) 氢、氨、甲醇等替代燃料在内燃机上的应用研究

(五) 新能源离网耦合制氢柔性控制关键技术研究

(六) 基于先进甲醇燃储电源的新能源微电网数字化调控关键技术